

HCT-900

국제공인



SMD 부품제거 및 장착장비 Hot Air Tool

Hot Air Tool은 밀집된 PCB상의 SMD 부품이나 소형부품제거 및 장착에 효과적입니다.

- 열풍조절이 간편.
- 다양한 형태의 노즐로 주변 부품의 손상방지.



제품 특징

- 온도 및 열풍 속도조절 가능.
- 소형부품에서 대형 SMD부품까지 손쉽게 작업 가능
- 다양한 형태의 노즐로 주변 부품의 손상방지.

제품 사양

- Power : 320W
- Air Flow : 5-25L/Min
- 필터 : Diaphragm
- 온도 : 100 C°~500 C°
- 크기 : L 210 x W 170 x H 140 mm
- 무게 : 4.7Kg

노즐 종류 및 사양

Outline : General Purpose Nozzles	Part Number	Dimension (mm)
	H - D25	2.5
	H - D50	5.0
	H - D120	12.0

Outline : Nozzles for SO & TSOP Packages	Part Number	Chip package	Dimension A	Dimension B
	H - S18	SOIC 14,18	8.8	10.2
	H - SL18	SOL 14,18	10.6	10.8
	H - SL20	SOL 20,20J	10.6	13.3
	H - SL24	SOL 24,24J	10.6	15.9
	H - SL28	SOL 28	10.6	18.4
	H - SL44	SOL 44	18.0	27.9
	H - SOJ32	SOJ 32	13.5	20.8
	H - SOJ40	SOJ 40	13.5	25.4
	H - TS24	20 - 24 PIN TSOP	17.0	7.1
	H - TS32	28 - 32 PIN TSOP	21.0	9.1
	H - TS40	40 PIN TSOP	21.0	10.8
	H - TS48	48 PIN TSOP	21.0	13.3
	H - TSW24	20 - 24 PIN TSOP	10.2	18.4
	H - TSW44	24-28/40-44PIN TSOP	12.7	19.8

Outline : Nozzles for PLCC, BQFP, QFP Packages	Part Number	Chip package	Dimension A	Dimension B
	H - P20	PLCC - 20	11.9	11.9
	H - P28	PLCC - 28	14.5	14.5
	H - P32	PLCC - 32	16.9	14.3
	H - P44	PLCC - 44	19.5	19.5
	H - P52	PLCC - 52	22.0	22.1
	H - P68	PLCC - 58	27.0	27.2
	H - P84	PLCC - 84	32.4	32.4
	H - Q07	QFP - 48	8.4	8.4
	H - Q10	QFP - 44	13.4	13.4
	H - Q14	QFP - 52,60	17.3	17.3
	H - Q1420	QFP - 84,90,100	23.4	18.1
	H - Q28	QFP-120,128,144,160	31.2	31.2
	H - BQ23	BQFP - 100	22.4	22.4
	H - Q3232	QFP - 240	34.5	34.5
	H - BQ38	BQFP - 196	37.7	37.7
	H - Q2626	QFP - 304	29.8	29.8

